

15%

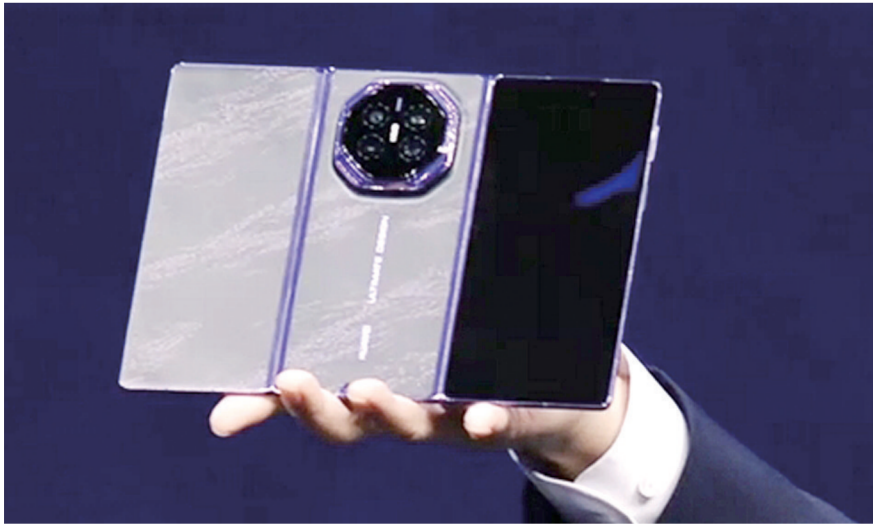
HarmonyOS 7 整机性能提升15%
续航延长36分钟以上

66%

麒麟9050 Pro芯片相比于麒麟9030 Pro
在部分关键任务上将功耗大幅降低了66%

华为三折叠新机售价很猛

售价19999元起;时隔六年发布高端芯片麒麟9050 Pro;鸿蒙7发布



9月7日,华为在广州举行新品发布会,鸿蒙全新一代操作系统 HarmonyOS 7、华为新款三折叠屏手机 HUAWEI Mate XT 2 非凡大师、全球首款阔直板机华为 Pura X View 等新品一众发布。其中,HUAWEI Mate XT 2 非凡大师19999元起,手写笔套装29999元。

新款三折叠搭载新芯片新系统

据介绍,HUAWEI Mate XT 2 非凡大师首发搭载麒麟9050 Pro,该芯片是首款采用逻辑折叠技术的高性能芯片,信号传输路径更短、时延更低、性能更好。这也是继华为Mate40全球发布会之后,华为时隔六年在旗舰发布会上推出全新麒麟芯片。据了解,麒麟9050Pro在单芯片内将逻辑单元分层排布,实现性能与能效双重跃升,整机性能较上代提升42%。

9月4日在中国科学院科技论文预发布平台上发布的论文中,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波表示,实测结果显示,麒麟9050 Pro芯片相比上一代麒麟芯片(麒麟9030 Pro),在每平方毫米上多容纳了55%的晶体管,运行中却更冷,并在部分关键任务上将功耗大幅降低了66%。

作为首发搭载 HarmonyOS 7 的手机,Mate XT 2 非凡大师及 Pura X View 不仅在硬件上有诸多亮点,在系统和应用体验上也实现了新突破。

硬件方面,Mate XT 2 折叠形态由前代的“Z/S”型(奏折式)折叠方案改为“G”型三折叠结构,并新增了一块独立外屏,支持通话、快捷回复与扫码支付等操作。Pura X View 则开启阔直板手机新时代。

系统和应用体验方面,华为 Mate XT 2 非凡大师将剪映专业版、国信金太阳智能版、中金财富e财富、Wind金融终端、东方财富、WPS、亿图图示、悟空图像、知网研学、ClassIn、CAJViewer 等十几款PC版应用适配至移动端,用户在办公、金融、创作等多场景均可实现PC级专业生产工具体验。

“将PC应用装进手机,专业办公。”华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东现场表示。

更多主流应用已深度适配华为三折

叠屏手机,带来大屏体验的全面升级。如钉钉在华为Mate XT 2上首发多个新功能和体验,首个接入灵盾防窥屏硬件能力,在他人从侧面窥看手机屏幕时页面为黑色,有效保护隐私,并且是鸿蒙首发窗口级安全投屏。

鸿蒙生态用户达1亿

据发布会信息,目前已有800+主流应用为Pura X View的阔屏进行专项优化。Pura X View还首次把小艺伴随式AI带到了直板机上,支持旅行规划功能,在做攻略时,可以智能识别屏幕,一步步整理出详细的旅途规划。

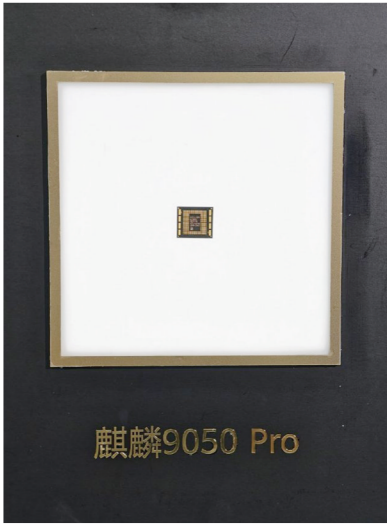
据了解,手机业硬件形态上的创新并非易事,因为一旦形态有变,系统、应用都要重新适配,否则就会直接影响用户手机体验。

行业分析人士指出,华为能在进行硬件创新的同时,同步做好用户体验及创新,关键在于其底层 HarmonyOS 7 的系统适配能力。华为联合大量伙伴应用、开发者完成的优化、适配,解决了屏幕变化带来的体验问题。“随着 HarmonyOS 7 的发布,以及越来越多鸿蒙终端的发布,鸿蒙应用体验进入成熟好用阶段,创新体验和创新应用会不断涌现。”

据华为方面数据,基于方舟引擎的深度优化,HarmonyOS 7 整机性能提升15%,续航延长36分钟以上。HarmonyOS 7 首次将学习了20亿数据量的性能大模型融入方舟引擎。方舟存储引擎采用超空间存储技术,用户从 HarmonyOS 6 升级 HarmonyOS 7 后,256GB 手机最多可节省22GB,512GB 手机最多可节省51GB,1TB 手机最多可节省109GB 存储空间。

据华为方面数据,截至目前,HarmonyOS 6 和 HarmonyOS 7 终端设备数已经超过8500万台。在此前举行的鸿蒙生态大会上,华为轮值董事长徐直军还透露,鸿蒙生态设备预计将在今年第四季度内突破1亿台。

他进一步分析,生态用户突破1亿,就如同达到了核裂变的“临界质量”或者飞机起飞的“离地速度”。1亿用户意味着鸿蒙生态将从导入期进入成长期,生态设备规模将持续增长,生态的两个飞轮开始正向转动。(新华社、证券时报)



▲麒麟9050 Pro芯片。

►新款三折叠手机。

◀发布会上展示的新款三折叠实机。

组图/华为发布会



➤ 相关新闻

7个月出口跑赢去年全年,中国“芯”还缺什么

7月份,我国规模以上工业企业集成电路产量达530亿块,相当于日均生产约17亿块芯片;今年前7个月,我国集成电路出口总额达2160亿美元,同比增长99.5%,已超2025年全年2019亿美元的出口总额。欣喜之余,仍需清醒看到行业隐忧。

三重因素催生产业飞跃

全球市场行情提供了强劲动力。全球AI浪潮打开巨大市场空间,对存储芯片需求激增,存储行业迎来超级周期,存储芯片成为拉动出口增长的主力品类,产品价格大幅上行,带动出口金额暴涨。

国内市场规模厚蓄了成长土壤。我国拥有全球超大规模的本土应用市场,人工智能、汽车电子、工业控制等领域需求持续释放,为芯片产业提供充足的试验场与成长土壤。内外市场双向赋能,造就产销两旺的局面。

完整产业链带来了供给优势。从设计、制造到封装测试,中国集成电路拥有全球少有的全链条能力。28nm及以上成熟制程芯片的中国产能全球占比已接近30%,而全球70%的芯片应用需求都集中在成熟工艺领域。当海外巨头将产能重心转向高端AI芯片时,深耕成熟工艺、产能稳定可靠的中国厂商精准承接了这波全球刚需。

产业深层矛盾尚待破解

技术壁垒与“卡脖子”风险犹存。尽管芯片产量与出口飙升,但高端芯片仍受制于国外技术封锁,关键材料、设备国

产化率不足,产业链安全存在隐忧。

产业结构隐忧显现。当前产能增长主要依赖存储芯片与成熟制程。中低端芯片产能集中,存在重复建设问题。高端芯片产能不足,存在结构性紧缺。

人才与生态短板制约长远发展。行业人才缺口大,芯片架构师、AI芯片专家、先进工艺整合师等顶尖人才更是稀缺,产学研用协同创新体系尚未成熟。

国际竞争压力持续加剧。美国对华技术围堵不断升级,全球半导体格局重塑充满不确定性,出口高增长能否持续面临考验。面对机遇与挑战并存的格局,中国集成电路产业需从“量的积累”转向“质的突破”。

锚定高端,突破“卡脖子”瓶颈。要持续加大研发投入,把资源向关键技术倾斜,聚焦设备、材料等薄弱环节集中攻关,用好新型举国体制,推动单项技术突破向全链条能力跃升。

深耕应用,构建产业生态护城河。芯片的价值最终要在应用中兑现。应依托国内庞大的新能源汽车、AI算力、物联网市场,构建上下游协同的产业生态,打通从技术突破到市场落地的“最后一公里”,以用促研,让中国“芯”在真实场景中迭代成长。

防范周期,增强产业韧性。半导体行业素有“牛短熊长”的周期规律。企业应避免盲目扩产、过度加杠杆。政府层面可建立产能预警机制,降低周期波动对产业的冲击。同时,积极开拓多元化出口市场,减少对单一市场的依赖。

(经济日报)